



2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年2月7日

上場会社名 日本電子材料株式会社 上場取引所 東
 コード番号 6855 URL <https://www.jem-net.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 坂田 輝久
 問合せ先責任者 (役職名) 執行役員 管理部門統括部長 (氏名) 石本 浩久 TEL 06-6482-2007
 配当支払開始予定日 —
 決算補足説明資料作成の有無 : 無
 決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2025年3月期第3四半期の連結業績(2024年4月1日~2024年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2025年3月期第3四半期	14,738	22.7	2,832	—	2,938	—	2,052	—
2024年3月期第3四半期	12,008	△21.9	23	△99.0	83	△96.7	△28	—

(注) 包括利益 2025年3月期第3四半期 2,097百万円(443.8%) 2024年3月期第3四半期 385百万円(△83.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2025年3月期第3四半期	162.52	—
2024年3月期第3四半期	△2.23	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2025年3月期第3四半期	35,109	26,144	74.5
2024年3月期	34,769	24,670	71.0

(参考) 自己資本 2025年3月期第3四半期 26,144百万円 2024年3月期 24,670百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2024年3月期	—	20.00	—	20.00	40.00
2025年3月期	—	30.00	—	—	—
2025年3月期(予想)	—	—	—	25.00	55.00

(注1) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

(注2) 2025年3月期期末配当金の内訳 普通配当 20円00銭 記念配当 5円00銭

3. 2025年3月期の連結業績予想(2024年4月1日~2025年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	20,600	18.0	3,600	313.5	3,400	237.6	2,400	285.5	190.02

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社(社名) 、除外 — 社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2025年3月期3Q	12,647,416株	2024年3月期	12,644,938株
② 期末自己株式数	2025年3月期3Q	15,900株	2024年3月期	15,857株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2025年3月期3Q	12,630,538株	2024年3月期3Q	12,621,270株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 4
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 8
(セグメント情報等の注記)	P. 8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 8
(継続企業の前提に関する注記)	P. 8
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	P. 8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費の持ち直しの一部に足踏みがみられたものの、雇用・所得環境の改善と各種政策の効果により、緩やかな回復傾向が続きました。しかしながら、欧米における高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響等、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇、アメリカの政策動向、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、生成AI向け需要が拡大する一方で、スマートフォンや自動車向け需要は依然として弱含んだ状態が続く等、一様ではない状況が続きました。

このような事業環境の中、当第3四半期連結累計期間の売上高につきましては、非メモリー向けプローブカードは需要が振るわず、前年同四半期をやや下回る結果となりました。メモリー向けプローブカードにつきましては、先端半導体用を中心に国内外に高付加価値製品の拡販を推し進めた結果、前年同四半期に対して回復傾向となりました。以上により、全体としては前年同四半期を上回る結果となりました。利益面につきましても、不安定な為替相場の影響や熊本新棟に係る一時的な費用等の発生があったものの、高付加価値製品を中心とした売上高の増加に加え、国内工場の稼働率向上等により、前年同四半期を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は14,738百万円（前年同四半期比22.7%増）、営業利益は2,832百万円（前第3四半期連結累計期間は23百万円）、経常利益は2,938百万円（前第3四半期連結累計期間は83百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は2,052百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失28百万円）となりました。

報告セグメント別の業績は次のとおりです。

a. 半導体検査用部品関連事業

半導体検査用部品関連事業の売上高につきましては、非メモリー向けプローブカードは需要が振るわず、前年同四半期をやや下回る結果となりました。メモリー向けプローブカードにつきましては、先端半導体用を中心に国内外に高付加価値製品の拡販を推し進めた結果、前年同四半期に対して回復傾向となりました。以上により、全体としては前年同四半期を上回る結果となりました。利益面につきましても、不安定な為替相場の影響や熊本新棟に係る一時的な費用等の発生があったものの、高付加価値製品を中心とした売上高の増加に加え、国内工場の稼働率向上等により、前年同四半期を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は14,570百万円（前年同四半期比23.1%増）、セグメント利益は3,755百万円（前年同四半期比354.6%増）となりました。

b. 電子管部品関連事業

電子管部品関連事業の売上高は167百万円（前年同四半期比0.6%減）、セグメント利益は8百万円（前年同四半期比19.2%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ340百万円増加し、35,109百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が2,969百万円、電子記録債権が689百万円、建設仮勘定が536百万円減少いたしましたが、製品が1,602百万円、仕掛品が262百万円、原材料及び貯蔵品が155百万円、建物及び構築物（純額）が2,514百万円増加したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,134百万円減少し、8,965百万円となりました。

これは主として、未払法人税等が601百万円増加いたしましたが、電子記録債務が485百万円、買掛金が218百万円、設備電子記録債務が249百万円、長期借入金が694百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,474百万円増加し、26,144百万円となりました。

これは主として、利益剰余金が1,421百万円、為替換算調整勘定が43百万円増加したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第4四半期の見通しにつきましては、プローブカード需要の回復は遅れているものの、生成AI市場の拡大を背景に、先端メモリ半導体向け製品の拡販が進み、当第3四半期と比べて売上は伸びる見通しです。利益面につきましても、熊本新棟に係る一時的な費用等の増加が見込まれるものの、年間を通じたメモリ向けプローブカードを中心とした高付加価値製品の拡販等により、当第3四半期を上回る見通しです。

一方で海外経済の下振れリスクや不安定な為替相場等、当社グループを取り巻く事業環境は不確実性の高い状態が続いております。

2024年9月25日に公表いたしました業績予想からの変更はございませんが、修正の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	14,217	11,247
受取手形	1	0
電子記録債権	1,308	619
売掛金	6,530	6,471
有価証券	34	35
製品	384	1,987
仕掛品	1,249	1,512
原材料及び貯蔵品	2,079	2,234
その他	349	431
貸倒引当金	△13	△17
流動資産合計	26,143	24,522
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	2,563	5,078
機械装置及び運搬具（純額）	3,055	2,849
建設仮勘定	1,084	548
その他（純額）	1,192	1,388
有形固定資産合計	7,896	9,865
無形固定資産	186	190
投資その他の資産		
その他	544	532
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	543	531
固定資産合計	8,626	10,587
資産合計	34,769	35,109
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	1,026	541
買掛金	1,152	933
設備電子記録債務	323	74
1年内償還予定の社債	100	100
1年内返済予定の長期借入金	1,178	1,037
未払法人税等	142	744
賞与引当金	471	258
その他	1,124	1,374
流動負債合計	5,519	5,062
固定負債		
社債	900	850
長期借入金	3,480	2,785
その他	199	267
固定負債合計	4,580	3,902
負債合計	10,099	8,965

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2024年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2024年12月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,069	3,074
資本剰余金	3,289	3,293
利益剰余金	17,626	19,048
自己株式	△16	△16
株主資本合計	23,969	25,399
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	6	7
為替換算調整勘定	693	736
その他の包括利益累計額合計	700	744
純資産合計	24,670	26,144
負債純資産合計	34,769	35,109

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
売上高	12,008	14,738
売上原価	8,700	8,600
売上総利益	3,307	6,137
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	718	794
退職給付費用	12	12
研究開発費	1,321	1,101
その他	1,232	1,396
販売費及び一般管理費合計	3,284	3,305
営業利益	23	2,832
営業外収益		
受取利息	17	26
受取配当金	22	10
為替差益	15	81
材料屑売却益	15	1
その他	16	20
営業外収益合計	87	140
営業外費用		
支払利息	19	21
社債利息	—	5
固定資産廃棄損	2	5
その他	6	0
営業外費用合計	27	34
経常利益	83	2,938
特別利益		
補助金収入	—	40
特別利益合計	—	40
税金等調整前四半期純利益	83	2,978
法人税、住民税及び事業税	147	894
法人税等調整額	△36	31
法人税等合計	111	926
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△28	2,052
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△28	2,052

四半期連結包括利益計算書
第3四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△28	2,052
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1	1
為替換算調整勘定	412	43
その他の包括利益合計	413	44
四半期包括利益	385	2,097
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	385	2,097

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

前第3四半期連結累計期間(自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	11,839	168	12,008	—	12,008
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	11,839	168	12,008	—	12,008
セグメント利益	826	9	836	△ 812	23

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第3四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	14,570	167	14,738	—	14,738
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	14,570	167	14,738	—	14,738
セグメント利益	3,755	8	3,763	△ 931	2,832

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年12月31日)
減価償却費	789百万円	853百万円